

证券代码：605111

证券简称：新洁能

无锡新洁能股份有限公司
投资者关系活动记录汇总表
(2020年11月)

编号：2020111401

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>券商策略会</u>
参与单位	<p>(以下排名不分先后)：</p> <p>大成基金、广发证券、鹏华基金、汇添富基金、交银施罗德、兴全基金、银华基金、浙商证券、融通基金、富国基金、建信基金、鸿道投资、华安证券、中银国际证券、新华基金、国华人寿、兴业基金、诺德基金、中融基金、东证融汇证券资管、泰信基金、瀚亚投资、东海基金、中加基金、长江养老保险、长盛基金、长信基金、鹏扬基金、于翼资产、汇安基金、中信建投基金、天弘基金、国信证券、惠升基金、光大保德信基金、长城基金、鑫元基金、国泰君安证券、西部证券、长江证券、嘉实基金、中泰证券、国盛证券、民生加银基金、海通证券、国投瑞银基金、中信保诚基金、信达澳银基金、华创证券、东方证券资管、中银基金、海富通基金、成泉资管、光大证券、汐泰投资、仁布投资、远策投资、平安资管、盘京投资、宝盈基金、敦和资管、创金合信基金、中海基金、彤源投资、东方证券自营、大象资管、景林资管、汇丰晋信基金、中欧基金、兴业证券资管、农银汇理、前海联合、华商基金、华夏久盈、华夏未来、华安基金、华富基金、华泰证券资管、华润元大基金、南华基金、博时基金、厚磊投资、合众资管、金鹰基金、金元顺安、中金公司、民生证券、上投摩根、十溢投资、上银基金、东吴人寿、东吴基金、东方基金、中再资产、人寿养老、中金基金、中银资管、乘安资产、九泰基金、人保资产、人寿资产、信诚基金、同泰基金、同犇投资、国寿资管、广钜投资、建信养老、恒泰华盛、慈阳投资、</p>

	<p>招商基金、晟盟资管、景顺长城、枫池资产、正心谷资本、民生信托、泓德基金、银河基金、英大保险资管、诺安基金、前海鸿富、玖歌投资、汇瑾资本、隆卿投资、宝弘景资管、成就资本、健顺投资、鸿凯投资、永成资本、君和资本、瀚朴投资、乐信投资、内方外圆、万峰资管、迪策投资、西部利得基金、金犇投资、大摩华鑫、国泰君安资管、国泰基金、国海证券、国联安基金、圆信永丰、圆沣投资、天治基金、太平养老、太平基金、太平资管、安信基金、富安达基金、工银瑞信、竣弘投资、广发基金、泰山保险、泰康资产、浙商基金、浙商资管、浦弘资本、海通证券自营、淳厚基金、泰达宏利基金、百年保险资管、益民基金、盛盈资本、红土创新、红杉资本、长江资管、开源证券、华夏基金、UG FUND等。</p>
<p>交流时间与地点</p>	<p>2020年11月3日 14: 00-14: 45 电话会议 2020年11月5日 10: 00-11: 30 无锡 2020年11月5日 14: 00-16: 00 无锡 2020年11月6日 13: 30-15: 30 上海 2020年11月9日 10: 00-11: 30 无锡 2020年11月9日 14: 30-16: 00 无锡 2020年11月9日 16: 00-17: 30 无锡 2020年11月10日 09: 30-11: 00 无锡 2020年11月10日 13: 30-15: 00 电话会议 2020年11月10日 15: 40-17: 00 无锡 2020年11月11日 10: 00-11: 30 无锡 2020年11月11日 15: 00-16: 00 电话会议 2020年11月12日 16: 00-17: 00 无锡 2020年11月12日 21: 00-22: 15 电话会议 2020年11月13日 09: 20-10: 30 无锡 2020年11月13日 15: 05-15: 55 电话会议 2020年11月13日 16: 50-18: 00 无锡</p>
<p>接待人员</p>	<p>董事长兼总经理朱袁正先生、董事会秘书肖东戈先生</p>

<p>投资者关系 活动主要 内容介绍</p>	<p>一、公司介绍环节</p> <p>公司成立于 2013 年 1 月，注册资本为 10,120 万元，拥有新洁能香港、电基集成两家全资子公司以及深圳分公司、宁波分公司。目前公司员工总共 210 余人，其中研发人员 70 余人。公司成立以来即专注于 MOSFET、IGBT 等半导体芯片和功率器件的研发、设计及销售，产品优质且系列齐全，广泛应用于消费电子、汽车电子、工业电子、新能源汽车及充电桩、智能装备制造、轨道交通、光伏新能源、5G 等领域。</p> <p>公司为国内 MOSFET 等半导体功率器件设计领域领军企业，2016 年以来连续四年名列“中国半导体功率器件十强企业”。公司已建立江苏省功率器件工程技术研究中心、江苏省企业研究生工作站、东南大学-无锡新洁能功率器件技术联合研发中心、江南大学-无锡新洁能功率器件技术联合研发中心。公司参与的“智能功率驱动芯片设计及制备的关键技术与应用”项目获得了 2019 年度江苏省科学技术一等奖，且获得 2020 年度国家技术发明奖提名并获得初评通过。截至目前，公司拥有 122 项专利，其中发明专利 36 项；同时公司参与在 IEEE TDMR 等国际知名期刊中发表论文 13 篇，其中 SCI 收录论文 7 篇。</p> <p>公司基于全球半导体功率器件先进理论技术开发领先产品，是国内率先掌握超结理论技术，并量产屏蔽栅功率 MOSFET 及超结功率 MOSFET 的企业之一，是国内最早在 12 英寸工艺平台实现沟槽型 MOSFET、屏蔽栅 MOSFET 量产的企业，也是国内 MOSFET 品类最齐全且产品技术领先的公司。同时，公司是国内最早同时拥有沟槽型功率 MOSFET、超结功率 MOSFET、屏蔽栅功率 MOSFET 及 IGBT 四大产品平台的本土企业之一，为国内 MOSFET 等功率器件市场占有率排名前列的本土企业。</p> <p>公司将进一步依托技术、品牌、渠道等综合优势，结合大尺寸晶圆芯片（8 英寸、12 英寸）先进工艺技术，开拓国际先进功率器件封装制造技术，全力推进高端功率 MOSFET、IGBT、集成功率器件的研发与产业化，持续布局半导体功率器件最先进的技术领域，并投入对 SiC/GaN 宽禁带半导体、智能功率器件的研发及产业化，提升公司核心产品竞争力和国内外市场地位。</p>
--------------------------------	--

二、问答交流环节

1、公司为什么选择 Fabless 作为公司的经营模式？

答：公司的定位是利用世界先进芯片代工厂的技术和产能资源进行产品的芯片开发与代工生产。

MOSFET、IGBT 相比于其他半导体功率器件具有较为优异或差异化的性能特征，因此，MOSFET、IGBT 的器件结构、参数性能需在更为严苛的工艺端才能实现或达到最优状态，这使得 MOSFET、IGBT 主要基于 8 英寸、12 英寸芯片工艺平台进行流片。

因 8 英寸、12 英寸芯片工艺平台生产线投资和运营成本巨大、且需投入庞大的尖端人力资源，因此国内 8 英寸、12 英寸芯片工艺平台生产线绝大多数由大型央企或国企或资金雄厚的企业投资建设，比如华虹宏力等。一般情况下，纯芯片代工厂商出于对芯片制造环节技术工艺保密的考虑，与国内 IDM 的半导体企业相比，代工厂更愿意与纯芯片设计公司开展合作，采用 Fabless 模式的半导体研发设计企业可以充分利用芯片代工厂商的工艺技术和产能资源，快速实现产业链协同提升。

公司是国内 8 英寸、12 英寸芯片工艺平台芯片投片量最大的半导体功率器件设计公司之一。公司的芯片代工供应商已经涵盖华虹宏力、华润上华、中芯集成等国内主要的纯芯片代工企业，公司与该企业建立了长期稳定的合作关系，并且在 MOSFET、IGBT 工艺沟通、技术交流、新技术更新等方面形成了通畅的交流平台。而且公司还与其他境内外领先的芯片代工企业逐步建立了合作关系，为公司进一步发展奠定了基础。

2、公司近两年产能如何保障？

答：公司的产能主要包括封测产能和芯片产能。

封测产能方面：国内的封装资源比较丰富，公司已与国内较多的封装厂建立了良好的合作关系，能够有效保证封测产能。

芯片产能方面：公司的芯片代工供应商已经涵盖华虹宏力、华润上华、中芯集成等国内主要的纯芯片代工企业，尤其是华虹宏力公司，公司与其建立了长期战略合作关系，在华虹宏力一厂、二厂、三厂、七厂均已实现投产。公司是国内 8 英寸芯片工艺平台芯片投片量最大的半导体功率器件设计公司之一，且 12 英寸平台公司已获得一定产能并正式投产，预计明年 12 英寸平台产能将获得进一步增长，成为公司芯片代工产能增长的重要来源之一。

同时，公司已在积极开发海外芯片代工厂，并建立了初步业务合作关系；随着疫情的逐步缓解，与海外芯片代工厂合作将进一步推进，公司的芯片代工产能可以获得有效保证。

3、公司未来产品结构的规划如何？

答：公司将进一步提升屏蔽栅 MOSFET 产品、超结 MOSFET 产品与 IGBT 产品的销售份额，未来占公司产品整体销售结构的 50%以上，预计明年 IGBT 产品的销售规模将获得较多增长。随着碳化硅和氮化镓等第三代半导体产品、集成功率器件的陆续推出，公司亦会积极推动相关产品的销售应用。

4、公司下游客户销售规模增长比较快的领域？

答：主要集中在工业电子、消费电子、5G 应用等方面。

5、芯片代工厂目前有涨价吗？公司的产品涨价计划？

答：公司目前尚未收到芯片代工厂的涨价通知，暂无产品涨价计划。

6、对于功率器件而言，12 英寸平台生产的产品比 8 英寸优势在哪儿？

答：一代设备、一代技术、一代工艺、一代产品。无论是从性能参数、可靠性、性价比等各方面，12 英寸平台生产的芯片均比 8 英寸产品更好。

7、公司设立电基集成子公司做封测的原因？

答：公司的定位是利用世界先进的芯片代工厂的技术和产能资源进行产品的芯片开发与代工生产。公司的技术和产品紧跟世界一流，由于封测技术的更新迭代很快，很多最新的产品公司在国内难以找到合适的封测代工资源；公司自建先进封装厂有利于保持技术和产品的先进性，可以生产国际已有而国内未

有的封装形式的功率器件。

8、公司做封测的发展方向？

答：公司做封测主要投向国际有的、国内很少甚至没有的先进封装技术。

比如 TOLL 封装形式，较好地缩减了其装片面积，相比传统封装形式，热阻减少了约 60%、寄生电感约为原来的 1/7，封装电阻约为原来的 1/6，能够降低系统成本并提供更高的系统可靠性。

10、公司关于封测方面的人才情况？

答：公司全资子公司电基集成的总经理具有 40 余年的封装经验，其他人员也多来自于国际与国内一流封装测试厂，具备丰富的研发经验与管理经验。此外，无锡及华东地区封装人才资源丰富，封装产业链完善。

11、公司产品在通信领域的应用？

答：目前主要与中兴通讯、烽火通信、TP-LINK 等公司建立了业务合作关系，5G 方面主要应用于 5G 基站主板上，由于 5G 基站对于器件的可靠性要求特别高，随着可靠性考核的临近结束，预计明年此方面应用上的销量将会进一步提升。

12、公司所处行业的竞争情况？

答：技术方面，公司主要对标国际一流厂商英飞凌。比如公司的屏蔽栅 MOSFET 产品、超结 MOSFET 产品以及高性能的 30V 以下以及 100V 以上的沟槽型 MOSFET 产品。

产品方面，普通沟槽型的 MOSFET 产品（如 30V-100V 之间的产品），在境内存在部分竞争；其他产品，仍以国产替代为主，公司与台湾地区企业、国际一流厂商等展开积极竞争。

13、公司对于之后的毛利率变动情况的看法？

答：公司对产品结构、市场和客户结构持续调整改善，进行产品创新与技术迭代；同时不断扩充电基集成封测现有产能、开展先进封测业务，为公司带

来积极的毛利率提升。如果产品销售价格获得进一步提升，整体毛利率亦会获得一定增长。

因此，预计未来一段时间内，公司的毛利率将处于稳步增长阶段。

14、公司预计功率器件这波行情可以持续多久？

答：从在手订单以及各方面反馈的综合信息，公司预计明年上半年仍可持续较为景气的市场行情，至于后期情况，仍需结合实际情况再进行论证判断。

15、公司未来想打造一个什么样的平台？

答：作为国内半导体功率器件领先企业，公司将依托国家对半导体等战略新兴行业发展战略支撑，专注于中高端半导体功率器件和集成器件的研发设计及销售。在保持 MOSFET、IGBT 产品技术和市场优势的基础上，公司将不断引进各类管理、技术、营销人才，构建高效、现代化的经营管理体系，进一步拓展 MOSFET 产品、重点深化 IGBT 产品、推出第三代半导体产品与集成功率器件产品，在该等产品领域成为国内自主创新、技术领先、品质高端的自主品牌的优质企业。

同时，公司将进一步借助国际先进的芯片代工资源，持续整合半导体功率器件先进封装测试环节垂直产业链，掌控先进半导体功率器件封装产线并推出 SiC/GaN 宽禁带半导体功率器件，进一步强化公司核心竞争力，积极优化下游各个细分领域头部客户服务方案，加快发展成为国际一流的半导体功率器件企业。

附件清单 (如有)	无
日期	2020年11月14日